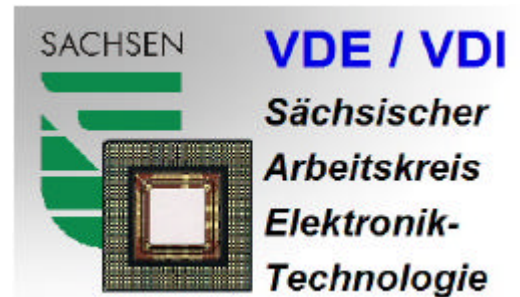


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)  
01069 Dresden  
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann  
Technische Universität Dresden  
Zentrum für mikrotechnische Produktion  
01062 Dresden  
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



Informationen zum Arbeitskreis im Internet: <http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

## 45. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

am **Donnerstag, 6. Oktober 2005 10:00 Uhr**  
beim **Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) e.V.**  
**Michael-Faraday-Str. 1; D-07629 Hermsdorf/Thur.**

**Thema: Hybrid- und Keramiktechnik für elektronische Baugruppen und Sensoren**

Leitung: Frau Dr. Bärbel Voigtsberger, Geschäftsführerin des HITK e.V.  
Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer, HTW Dresden, Fachbereich Elektrotechnik

- 10:00 Uhr Begrüßung und aktuelle Informationen zum Arbeitskreis**  
Herr Prof. R. Bauer, Herr Dr. M. Oppermann
- 10:15 Uhr Vorstellung des Standortes Hermsdorf und des Hermsdorfer Institut für Technische Keramik**  
Frau Dr. B. Voigtsberger, GF HITK e.V.
- 10:45 Uhr Keramische Siebdruckschichten in der Sensorik**  
Herr Dr. S. Barth, HITK e.V.
- 11:15 Uhr Hochleistungsoxidkeramiken für Anwendungen in Sensorik und Mikrosystemtechnik**  
Herr H. Ludwig, HITK e.V.
- 11:45 Uhr Ergebnisse und Erfahrungen bei der Implementierung RoHS-konformer Prozesse und Werkstoffe in die Serienfertigung von elektronischen Baugruppen und Hybriden**  
Herr M. Höfer, Lust Hybrid-Technik GmbH
- 12:15 Uhr Mittagspause**
- 13:00 Uhr Neue Packaginglösungen mit niedrigsinternder Mehrlagenkeramik LTCC**  
Herr F. Bechtold, GF Via Electronic GmbH
- 13:30 Uhr Dünnschichttechnik für Sensoren und Verbindungsstrukturen**  
Herr W. Brode, GF Siegert TFT GmbH
- 14:00 Uhr Dickschicht-Hybridtechnik und Sensorik**  
Herr K-H. Suphan, Micro-Hybrid Electronic GmbH
- 14:30 Uhr Abschlussdiskussion**
- 15:00 Uhr Besichtigungen im HITK e.V. und ausgewählten Betrieben**
- 16:30 Uhr Abschluss**

Alle Interessenten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Um eine rechtzeitige Teilnahmemeldung wird gebeten. Kontaktaufnahme bitte an Herrn Prof. R. Bauer ([bauer@et.htw-dresden.de](mailto:bauer@et.htw-dresden.de), Tel.: 0351/462 3605, Fax: 0351/462 2175).